

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成23年12月1日(2011.12.1)

【公開番号】特開2011-6710(P2011-6710A)

【公開日】平成23年1月13日(2011.1.13)

【年通号数】公開・登録公報2011-002

【出願番号】特願2010-230488(P2010-230488)

【国際特許分類】

C 08 J 5/18 (2006.01)

C 08 L 101/00 (2006.01)

C 08 K 3/00 (2006.01)

【F I】

C 08 J 5/18 C F H

C 08 L 101/00

C 08 K 3/00

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月14日(2011.10.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下、20 での伸びが10%以上であり、
エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂からなる結合剤によって
無機充填剤が結合されてなる樹脂フィルム。

【請求項2】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下、20 での伸びが10%以上であり、
エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂からなる結合剤によって
無機充填剤が結合され、20 での弾性率が10 GPa以下である樹脂フィルム。

【請求項3】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下、20 での伸びが10%以上であり、
エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂からなる結合剤によって
無機充填剤が結合され、硬化後の20 での熱膨張係数が100 ppm/K以下である樹脂フィルム。

【請求項4】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下であり、エポキシ基及びアミノ基から選
択される基を有する熱硬化性樹脂を結合剤として含有し、この結合剤100重量部に対し
て無機充填剤を100~2,000重量部含有する組成物からなり、硬化後の20 での
弾性率が10 GPa以下である樹脂フィルム。

【請求項5】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下であり、エポキシ基及びアミノ基から選
択される基を有する熱硬化性樹脂を結合剤として含有し、この結合剤100重量部に対し
て無機充填剤を100~2,000重量部含有する組成物からなり、硬化後の20 での
熱膨張係数が100 ppm/K以下である樹脂フィルム。

【請求項6】

20 での貯蔵弾性率が1,000 MPa以下、20 での伸びが10%以上であり、

エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂からなる結合剤によって無機充填剤が結合され、20°での弾性率が10GPa以下である硬化物。

【請求項7】

20°での貯蔵弾性率が1,000MPa以下、20°での伸びが10%以上であり、エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂からなる結合剤によって無機充填剤が結合され、硬化後の20°での熱膨張係数が100ppm/K以下である硬化物。

【請求項8】

20°での貯蔵弾性率が1,000MPa以下であり、エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂を結合剤として含有し、この結合剤100重量部に対して無機充填剤を100~2,000重量部含有する組成物からなり、硬化後の20°での弾性率が10GPa以下である硬化物。

【請求項9】

20°での貯蔵弾性率が1,000MPa以下であり、エポキシ基及びアミノ基から選択される基を有する熱硬化性樹脂を結合剤として含有し、この結合剤100重量部に対して無機充填剤を100~2,000重量部含有する組成物からなり、硬化後の20°での熱膨張係数が100ppm/K以下である硬化物。